



# R4D高功率 半导体激光模组

R4D是杏林睿光半导体AW系列多功能激光模组，单波长输出，光纤插拔式设计。配置指示光、光纤开关、PD探测器、热敏电阻等功能。

## 主要功能特点

- ◆ 可靠性高
- ◆ 功率稳定
- ◆ 光斑均匀
- ◆ 散热好
- ◆ 波长可选

## 应用

- 光谱检测
- 生物医疗
- 材料分析
- 显示照明
- 激光制造

## 技术参数（25℃）

封装形式		R4D				
		红光	单波长			
中心波长（nm）		650	808	980	1064	1470
光学	连续输出功率 P <sub>op</sub> （W）	0.5	45	50	45	15
	波长公差（nm）	±10				
	光谱宽度 Δλ（nm）	<6				
	波长随温度特性 Δλ/ΔT（nm/℃）	0.3				
电学	阈值电流 I <sub>th</sub> （A）	0.5	1.8	1.2	1.2	1.4
	工作电流 I <sub>op</sub> （A）	1.2	14	20	15	15
	工作电压 V <sub>op</sub> （V）	2.3	8	5.4	6.8	5.8
	微分效率 η <sub>es</sub> （W/A）	0.7	3.7	2.7	3.3	1.1
	PD电流 I <sub>pd</sub> （μA）	<8000				
	热敏电阻参数 Rt（kΩ/β（25℃））	10±1%/3930				
光纤	光纤芯径 D <sub>core</sub> （μm）	400				
	光纤包层直径 D <sub>clad</sub> （μm）	440				
	光纤涂覆层直径 D <sub>buffer</sub> （μm）	720				
	数值孔径 NA	0.22				
	连接器	SMA905				

注：1. 以上表格内所有数据均为室温25℃环境下测试所得的典型值，最终数据以出厂测试报告为准。

## 其他参数

参数	工作温度（℃）	工作相对湿度（%）	存储温度（℃）	存储相对湿度（%）	引脚焊接温度（max/℃）
最小	10	-	-20	-	-
最大	30	75	70	90	250(10Sec.)

